

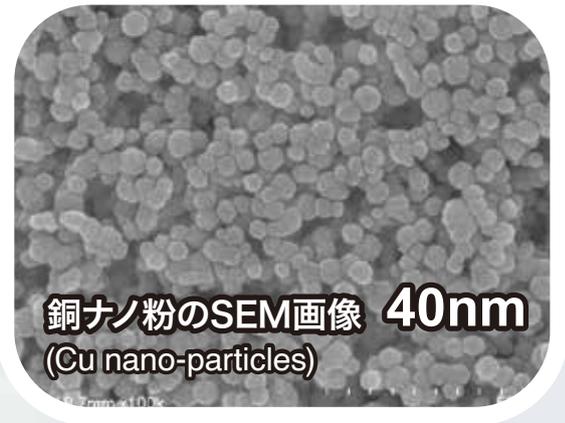
導電性 銅ナノインク

Conductive Cu Nano Ink

特徴 (Features)

当社銅ナノインクは原料の銅ナノ粉からインクまでを自社で一貫生産しており、プリントエレクトロニクスに必要とされる均一な粒径で安定した品質を有します。

Our Conductive Copper Nano-Ink is manufactured by integrated production process from Cu nano-particles to ink, which has stabilized quality with required uniform particle size in Printed Electronics.

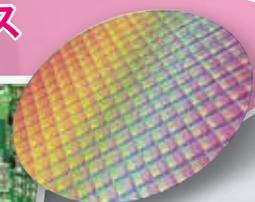
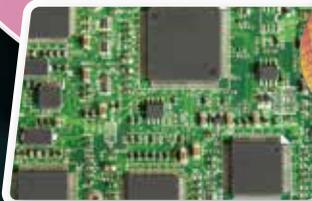


5G・6G
RFタグ
(RF tag)



車載部品
EV・FCV
(Automobile parts)

パワーデバイス
(Power device)



特長 (Features)

- 1** 純銅に近い比抵抗が得られます。
The resistivity of Cu film is close to that of bulk copper.
- 2** 紙、エンジニアリングプラスチック、金属、ガラス等の基材上で印刷により回路形成が可能です。
Minute Cu circuit patterns can be formed by printing on paper, engineering plastic, metal, and glass.
- 3** 耐マイグレーション性に優れます。
Superior migration resistance.

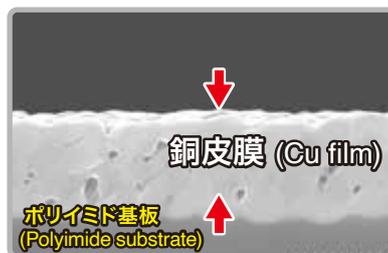
印刷方法 (Printing process)

インクジェット、フレキソ、グラビアオフセット、スクリーン、スクリーンパットに対応
Inkjet, Flexographic, Gravure offset, Screen, and Screen pad.

焼成方法 (Sintering process)

フォトシタリング、
還元雰囲気焼成
(ギ酸リフロー等)

Photo-sintering, or Sintering in reducing atmosphere (Reflow with formic acid vapor etc.)



適用基材 (Applicable substrate)

紙、PI、PET、耐熱PC、PEN、PPS、LCP、銅、ガラス、等に対応

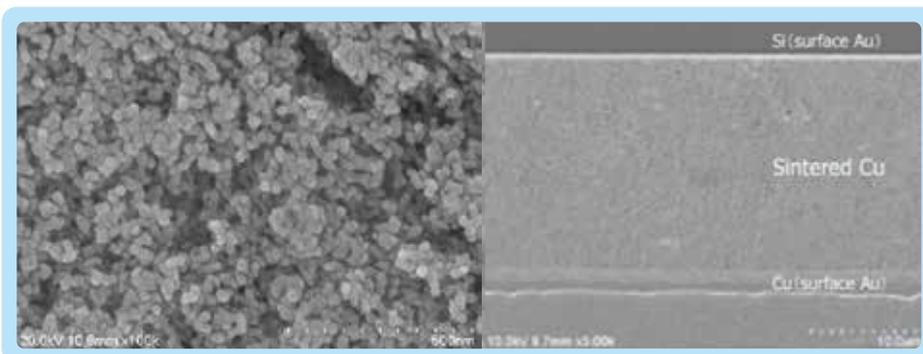
Paper, polyimide(PI), PET, PC, PEN, PPS, LCP, Cu, Glass etc.

アプリケーション (Application)

RFタグ、アンテナ、プリント配線基板、タッチセンサー、電子部品、メタルメッシュ、めっき下地、等に対応

RF Tag, Antenna, Printed circuit board, Touch sensors, Electronic component, Metal mesh, Seed layer for plating, etc

その他用途 (Other use)



加圧焼結型接合材料
(窒素ガス雰囲気での焼成)

Pressure sintering Cu bonding paste
(Sintering with Nitrogen gas)

せん断強度 50MPa以上
Shear strength : 50 MPa and over

